



Technical Data Sheet

EXBOND1836AB

Room Temperature Curing Adhesive

August 2017

产品描述

EXBOND 1836AB 灌封胶为双组份有机硅加成体系导热灌封胶。适用于有大功率电子元器件以及对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护, 如 LED 驱动电源、汽车 HID 灯模块电源、汽车点火系统模块电源、家电控制器等。

特性

胶料在常温条件下混合后存放时间较长, 但在加热条件下可快速固化, 特别利于自动生产线上的使用; 耐温性, 耐高温老化性好; 固化后在在很宽的温度范围 (-60~280°C) 内保持橡胶弹性, 绝缘性能优异; 固化过程中不收缩, 具有更优的防水防潮和抗老化性能; 具有阻燃性, 阻燃性能达到 UL94-V0 级。

胶液性能

固化前性能	1836A	1836B
外观	灰色	白色
粘度/cp	6000-7000	6000-7000
混合比例 (质量比)	1	1
混合粘度/cp	6000-7000	
固化条件	EXBOND 1836AB	
操作时间/min	30	25°C
固化时间/min	180	25°C
固化时间/min	20	80°C
固化后性能	EXBOND 1836AB	测试方法及概述
邵氏硬度/A	50-60	ASTMD 2240
导热系数/w/mk	≥1.2	ASTM-D5470
体积电阻系数/Ω·cm	≥10 ¹⁶	GB/T 1410-2006
介电常数, MHZ	3.0-3.3	GB1409-88
阻燃性能	UL94-V ₀	GB8410

上述数据仅可视为产品标准值, 不当作为技术规格使用。

使用说明

运输

在运输过程中该产品存放于室温环境中即可。

使用工艺

- 1, 按配比称量两组分放入混合罐内搅拌均匀即可;
- 2, 将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内, 一般可不抽真空脱泡, 若需得到高导热性, 建议真空脱泡后再灌注。
- 3, 胶的固化速度与固化温度有很大关系, 在冬季需要很长时间才能固化, 建议加热方式固化, 80℃下固化 15-30 分钟, 室温条件下一般需要 3 小时左右固化。

贮藏

- 1, 胶料应该密封保存, 储存期一年;
- 2, 长时间存放后, 胶中填料会有所沉降, 请搅拌均匀后使用, 不影响性能;

使用要求

为了获得最佳的性能, 被粘结表面需要干燥、清洁;
按比例准确取样, 且混合后充分搅拌均匀, 以免固化不完全;
请及时灌胶, 并在可操作时间内使用完已混合的胶液;
固化过程中, 请保持环境干净, 以免杂质落入未固化的胶液表面; 详细的使用说明请联系 Bonotec 技术服务部。

固化

EXBOND 1836AB 胶黏剂全部固化条件建议请查阅 TDS 中的固化条件一栏。

包装形式

EXBOND 系列产品可以按照客户的要求装载于塑料桶或大口瓶中。A 胶包装规格包括 5 公斤、10 公斤、20 公斤、25 公斤, B 胶根据 A 胶数量按比例包装。详细情况可以参考 Bonotec 标准包装数据或与当地的客户服务代表联系。

本产品对于皮肤敏感的人具有一定的致敏性, 应避免皮肤直接接触。若不慎接触, 请用肥皂和水冲洗, 具体方法详见化学品安全说明书 (MSDS, Material Safety Data Sheet)。

声明

上述的测量数据仅代表材料本身典型性能, 不应当作为技术规格使用。本诺认为这些数据的测量和操作方式是精确的, 但不能为其精确性做出保证。
本诺建议用户在使用该产品前根据自己的操作方法和工艺条件判断其是否适合于特定的应用。本诺的工程师也将会帮助用户更好的使用该产品, 满足用户应用要求。本诺从未授权任何人免除或改变上述条款。